

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML4

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		2	
B-RS-FR4-DS-1.20mm-018+018-TG150-HF	50200899	33	L2	3	
		1164			
		33	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		4	
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	RS	5	

Dicke nach Verpressen

B00: 1440 µm Tol+: 155 µm Tol-: 155 µm Dmax: 1595 µm Dmin: 1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm Tol+: 0 µm Tol-: 0 µm Dmax: 0 µm Dmin: 0 µm

Kundenforderung

Dicke (D): 1550 µm Tol+: 155 µm Tol-: 155 µm Dmax: 1705 µm Dmin: 1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig nominal: 1368 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik